

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood
投資者關係資深總監
(408) 875-9529
ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers
企業宣傳資深總監
(408) 875-8733
meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 為領先的積體電路技術推出晶圓全面檢測與檢查系列產品 先進缺陷檢測與製程監控因應 10 奈米良率挑戰

【加州三藩市 2016 年 7 月 11 日訊】在 SEMICON West 上，[KLA-Tencor Corporation](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）今天為前沿積體電路裝置製造推出了六套先進的缺陷檢測與檢查系統：3900 系列（以前稱為第 5 代）和 2930 系列寬頻電漿光學檢測儀、Puma™ 9980 雷射掃描檢測儀、CIRCL™5 全表面檢測套件、Surfscan® SP5^{XP} 無圖案晶圓檢測儀和 eDR7280™ 電子顯微鏡和分類工具。這些系統採用一系列創新技術形成一套全面的晶圓檢測解決方案，使積體電路製造的所有階段 — 從早期製程表徵到生產製程監控 — 都能實現良率關鍵缺陷的檢測與控制。

KLA-Tencor 晶圓檢測事業部執行副總裁 Mike Kirk 表示：「與我們的客戶及早協作加強了我們對未來製程節點檢測要求的理解，並且讓我們能夠精準調整研發與工程設計工作的方向，推出協助客戶解決關鍵良率問題的檢測系統和解決方案。例如，3900 系列寬頻電漿檢測儀不僅具備引人矚目的檢測效能 — 10 奈米以下缺陷的光學偵測 — 而且還能協助我們的客戶對其最複雜的元件設計進行進程偵錯。我們新的晶圓檢測系列產品中的所有系統整合了支援先進缺陷檢測與監控的多種創新技術，使我們的客戶能夠開發並快速生產改善他們的尖端元件。」

缺陷檢測

3900 系列、2930 系列和 eDR7280 將檢測、設計及檢查資訊融為一體，形成一套缺陷檢測解決方案，透過對關鍵缺陷的偵測與表徵，促進了製程和良率改善。這套解決方案可協助積體電路製造商因應先進設計節點的挑戰，例如與圖案增殖及製程系統缺陷相關的製程範圍檢測和良率損失。

革命性的 3900 系列寬頻電漿光學檢測儀採用新型超解析度深紫外線 (SR-DUV) 波長範圍和曝光機級別晶圓台精準性產生卓越的光學解析度，經證實能夠偵測 10 奈米以下缺陷。2930 系列寬頻電漿光學檢測儀採用 DUV/UV 波段，可以補充 3900 系列的不足，確保在所有製程站點上的良率相關缺陷偵測均能達到最佳對比度。兩款寬頻電漿光學檢測儀可在大約 1 小時內提供完整的晶圓檢測，允許採集晶圓集和批次級缺陷資料，藉此全面理解和迅速偵錯複雜的製程問題。

在 3900 系列和 2930 系列兩套系統上，均利用了透過 pin • point™ 和 super • cell™ 專利技術獲得的設計資訊 — 在關鍵特性（包括與設計弱點相關的那些特性）方面改善對於影響良率缺陷的檢測靈敏度，以及減少與諸如測試圖案等非關鍵特性相關之雜訊。eDR7280 電子顯微鏡系統

具備增強型影像記錄和自動缺陷分類能力，能夠精準表述由寬頻電漿檢測儀偵測出的缺陷群，從而大幅度縮短缺陷檢測所需時間。

缺陷監控

Puma 9980、CIRCL5 和 Surfscan SP5^{XP} 能夠及早識別各種生產線、製程及工具監控應用上的良率偏差，協助晶片製造商加快產能提升，並最大限度地改善前沿領先裝置技術的良率。Puma 9980 雷射掃描檢測儀具備增強型缺陷類型擷取能力，支援整個生產線前段和後段先進成圖應用的高產能提升監控。Puma 9980 的新型 [NanoPoint™](#) 支援設計能力可改善缺陷靈敏度，並抑制系統雜訊缺陷，增加了檢測結果的良率相關性。

CIRCL5 包括使用並行資料採集進行快速且具有成本效益監控的可配置模組：8920i 正面檢測模組，CV350i 邊緣檢測、檢查與量測模組，BDR300 背面檢測與檢查模組，以及自動微缺陷檢查與量測模組。透過關聯所有晶圓表面的檢測結果，例如邊緣剝落缺陷與正面顆粒缺陷之間相關聯，CIRCL5 能夠促進對生產偏差來源的迅速識別。

Surfscan SP5^{XP} 無圖案晶圓檢測儀採用擴展型 DUV 技術和創新演算法創造出新型作業模式，對於以具有成本效益的方式及早偵測出相關隨機底材或薄膜缺陷與偏差至關重要。一種模式為先進的進程偵錯應用提供了業界領先的靈敏度，而另一種模式則在 Surfscan 平台上為生產製程監控提供了迄今最高的產能。

世界各地的積體電路製造商已安裝了多款 3900 系列、2930 系列、Puma 9980、CIRCL5、Surfscan SP5^{XP} 和 eDR7280 系統，用於在先進技術節點進行邏輯電路和記憶體元件的研發與產能提升。2930 系列、Puma 9980、CIRCL5、Surfscan SP5^{XP} 和 eDR7280 可以從其前代產品進行現場升級，提供了保護晶圓廠資本投資的可擴展能力。為了保持高效能和高產能，所有六套系統均由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路提供支援](#)。如需更多資訊，請瀏覽[先進晶圓檢測系列產品網頁](#)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司是製程控制管與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，四十年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 www.kla-tencor.com (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 3900 系列、2930 系列、Puma 9980、Surfscan SP5^{XP}、CIRCL5 和 eDR7280 系統的預期效能，3900 系列、2930 系列、Puma 9980、Surfscan SP5^{XP}、CIRCL5 和 eDR7280 系統相對於未來技術節點的可擴展性，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 3900 系列、2930 系列、Puma 9980、Surfscan SP5^{XP}、CIRCL5 和

eDR7280 系統的預期使用，以及 3900 系列、2930 系列、Puma 9980、Surfscan SP5^{XP}、CIRCL5 和 eDR7280 系統使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###